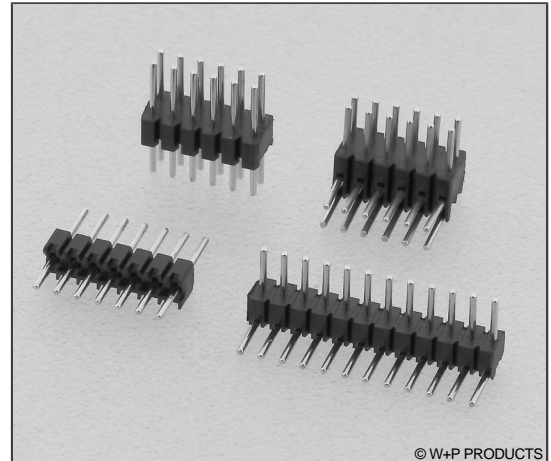


## Stiftleisten RM 1,27mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-reihig – Rundstifte 0,42mm Pin Headers, 1.27mm Pitch, Straight/Right-Angled, Single/Double Row – 0.42mm Round Pins

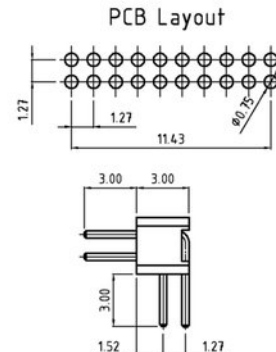
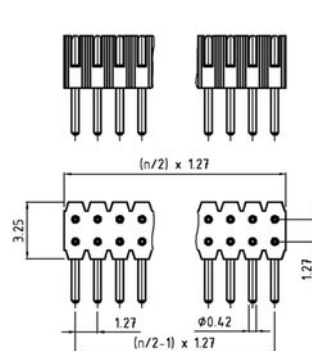
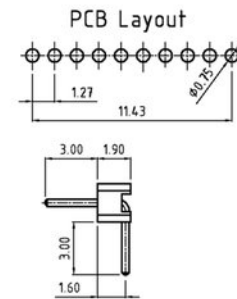
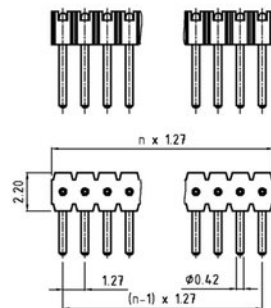
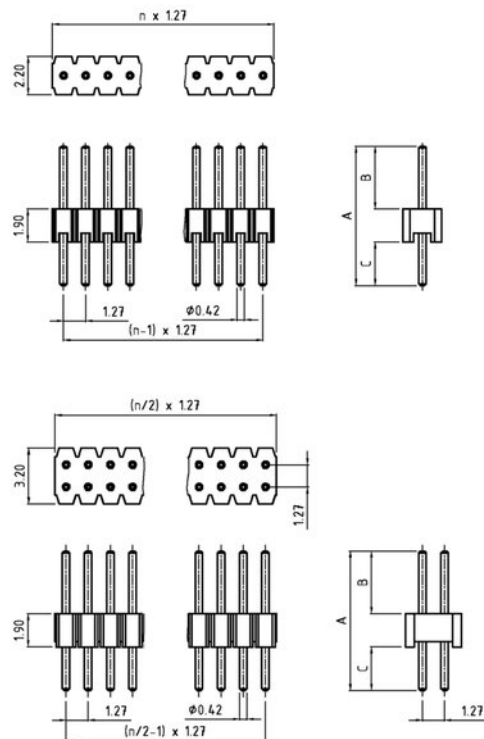
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Rundstift Ø0,42mm, Kupferlegierung <i>Ø0,42mm round pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**155** etc.  
e siehe Kapitel B  
*see ch. B for more*



Series	Dimensions*	Type*	Contacts*	Plating*
<b>755</b>	<b>07</b>	<b>10</b>	<b>001</b>	<b>00</b>
	<b>07</b> A=8,00 B=3,60 C=2,50mm <b>09</b> A=8,60 B=4,20 C=2,50mm <b>13</b> A=12,90 B=8,50 C=2,50mm <b>91</b> Einreihig, gewinkelt (s. Zng.) <i>Single row, right-angled (as shown in dwg.)</i> <b>92</b> Zweireihig, gewinkelt (s. Zng.) <i>Dual row, right-angled (as shown in dwg.)</i> <b>99</b> Kundenspezifisch <i>Customer-specific</i>	<b>10</b> Einreihig, gerade <i>Single row, straight</i> <b>11</b> Einreihig, gewinkelt (nur Dim. Code 91) <i>Single row, right-angled (dim. code 91 only)</i> <b>20</b> Zweireihig, gerade <i>Double row, straight</i> <b>21</b> Zweireihig, gewinkelt (nur Dim.Code 92) <i>Double row, right-angled (dim. code 92 only)</i>	<b>001-050</b> Einreihig <i>Single row</i> <b>002-100</b> Zweireihig <i>Double row</i>	<b>00</b> Vergoldet <i>Gold plated</i> <b>50</b> Verzinkt <i>Tin plated</i>

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



### Reflow-Lötempfehlung

*Reflow Soldering Recommendation*

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).*

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

